

淡江大學 99 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	電子構裝	授課 教師	楊龍杰 Yang Lung-jieh
	ELECTRONIC PACKAGING		
開課系級	機電三 P	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TEBXB3P		

學系(門)教育目標

- 一、教育學生應用數學、科學及工程的原則，使其能成功的從事機電工程相關實務或學術研究。
1. 培養學生具備學理基礎。
 2. 培養學生具備工程應用之能力。
 3. 培養學生資訊化能力。
- 二、培養健全的專業工程師，使其專業素養與工程倫理認知能充分發揮於職場，滿足社會需求。
1. 培養學生創造、設計、製作及工程規劃與整合之能力。
 2. 培養學生具備設計與執行實驗，以及發掘、分析、解釋、處理問題之能力。
 3. 培養學生守法奉獻、尊重自然及敬業守分之責任。
- 三、培育學生預備全球競爭的基本技能，以迎接不同的生涯選項並對終身學習奠定良好的基礎。
1. 培育學生表達溝通及團隊合作之能力。
 2. 培育學生應用外語與拓展國際觀。
 3. 培育學生持續學習的認知與習慣。

學生基本能力

- A. 具備機電工程與應用所需的工程知識。
- B. 繪圖、加工與公差管理能力。
- C. 基礎程式設計及相關資訊工具能力。
- D. 邏輯思考分析整合及解決問題能力。
- E. 創新設計與工程實作能力。
- F. 應用外語能力與世界觀。
- G. 團隊合作思維。
- H. 專業倫理認知。
- I. 終身學習精神。

課程簡介	本課程提供學生對電子構裝之全面瞭解，其牽涉到電子、材料、物理、化學、與機械等跨領域知識的合作與學習。
	This course provides the overall understanding of the electronic packaging involving the system integration of electronics, material science, physics, chemistry, and mechanics.

本課程教學目標與目標層級、學生基本能力相關性

一、目標層級(選填)：

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域：C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域：P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域：A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「學生基本能力」之相關性：

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如：認知「目標層級」對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應該系「學生基本能力」。單項教學目標若對應「學生基本能力」有多項時，則可填列多項「學生基本能力」(例如：「學生基本能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列)。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)	相關性	
			目標層級	學生基本能力
1	了解電子構裝產業與相關工程技術	train the students with sufficient knowledgement in electronic packaging and corelated tech.	C3	AEG
2	訓練修課同學具有電子構裝設備之實作經驗	train the students with the hands-on experience of the processing machines in electronic packaging.	P1	ADEG
3	了解電路板線路繪圖軟體protel之初步使用	have a basic idea of using the electronic packaing software- Protel	P1	ABCE
4	了解如何檢索專利	learn how to survey the patents of intelligence properties	P1	ACDE

教學目標之教學策略與評量方法

序號	教學目標	教學策略	評量方法

1	了解電子構裝產業與相關工程技術	課堂講授	出席率、小考、期中考、期末考
2	訓練修課同學具有電子構裝設備之實作經驗	參觀實習	出席率、報告、期中考、期末考
3	了解電路板線路繪圖軟體protel之初步使用	參觀實習	出席率、報告、期中考、期末考
4	了解如何檢索專利	參觀實習	出席率、報告、期中考、期末考

授 課 進 度 表

週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)	備註
1	100/02/14~ 100/02/20	緒論/矽晶圓/積體電路製作	
2	100/02/21~ 100/02/27	電子構裝簡介/切割黏晶與打線	
3	100/02/28~ 100/03/06	E813半導體製程影片欣賞/參觀K001A微機電無塵室/參觀機械工廠之晶圓切割機/熱工K001認識印刷電路板與製作設備	
4	100/03/07~ 100/03/13	導線架/轉注成型與封裝材	
5	100/03/14~ 100/03/20	蓋印與成型/印刷電路板-1	
6	100/03/21~ 100/03/27	印刷電路板-2/軟焊與焊料-1	
7	100/03/28~ 100/04/03	軟焊與焊料-2/陶瓷構裝	
8	100/04/04~ 100/04/10	球柵陣列構裝/晶片尺寸構裝	
9	100/04/11~ 100/04/17	覆晶接合/液態封裝與點膠	
10	100/04/18~ 100/04/24	期中考試週	
11	100/04/25~ 100/05/01	電路板線路繪圖軟體Protel教學	
12	100/05/02~ 100/05/08	印刷電路板製作示範與實習	
13	100/05/09~ 100/05/15	電性與熱導	
14	100/05/16~ 100/05/22	預燒與可靠度分析	
15	100/05/23~ 100/05/29	電子構裝材料分析	
16	100/05/30~ 100/06/05	中華民國專利檢索教學	
17	100/06/06~ 100/06/12	補充：探針卡	
18	100/06/13~ 100/06/19	期末考試週	

修課應注意事項	參觀,PCB實作,Protel試畫與專利檢索共4次作業報告
教學設備	電腦、投影機
教材課本	大部份週次採用陳信文等著,“電子構裝技術與材料”,高立書局,2008年
參考書籍	1.部分週次內容由任課老師補充材料與實作教學 2.Tummala, Fundamentals of Microsystems Packaging, McGrawHill (高立/微系統構裝基礎原理/陳信文譯), 2002
批改作業篇數	4 篇 (本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫)
學期成績計算方式	◆平時考成績：20.0 % ◆期中考成績：30.0 % ◆期末考成績：30.0 % ◆作業成績： 20.0 % ◆其他〈 〉： %
備考	「教學計畫表管理系統」網址： http://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處首頁〈網址： http://www.acad.tku.edu.tw/index.asp/ 〉教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。 ※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。